

# 支持 SMBus 和 I<sup>2</sup>C 通信、兼容 LM75 的低功耗数字温度传感器

Datasheet\_V1.3 Dec. 2024

#### 1 基本性能

测温范围: -55℃ ~ +125℃

• 测温精度: ±0.5℃ (-40℃ ~ +125℃)

高分辨率: 9~12bits(用户自定义)

• 电源电压: 1.6V~5.5V

• 转换时间: 26ms

低功耗:转换电流40µA,关断电流0.3µA

数字输出:兼容SMBus、I<sup>2</sup>C接口

• 封装信息:

| 产品型号   | 封装形式     | 封装尺寸(mm²)   |
|--------|----------|-------------|
| GX175  | SOP (8)  | 4.90 × 3.90 |
| GX175U | MSOP (8) | 3.00 × 3.00 |
| GX175D | DFN (8)  | 3.00 × 2.00 |
| GX175N | DFN (8)  | 2.00 × 2.00 |

## 2 应用场景

- 电源温度监控
- 电脑外部设备热保护
- 笔记本电脑
- 手机
- 电池管理
- 办公机器
- 恒温控制
- 机电设备温度

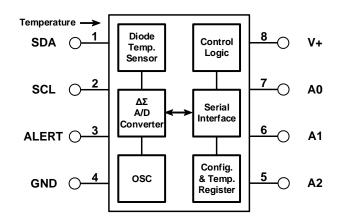
### 3 芯片概述

GX175是一款高精度、低功耗、可替代NTC/PTC 热敏电阻的数字温度传感器,可用于通信、计算机、消 费类电子、环境、工业和仪器仪表应用中的温度测量。 GX175在-40℃至+125℃的正常工作范围内,可提供 ±0.5℃的测温精度,并具有良好的温度线性度。

GX175的额定工作电压范围为1.6V ~ 5.5V, 在实际的温度转换中的静态电流低至 $40\mu A$ 。集成在芯片内部的ADC分辨率低至 $0.0625^{\circ}C$ 。

GX175采用8-Pin SOP / MSOP / DFN封装,支持 SMBus和I<sup>2</sup>C通信。在一条总线上最多可挂载27个不同 地址的GX175芯片。GX175具有SMBus报警功能。

#### GX175内部结构示意图





# 10 订购信息

| 订购编号       | 芯片型号   | 封装信息            | 标准包装数量 | 备注                |
|------------|--------|-----------------|--------|-------------------|
| GX175-T&R  | GX175  | SOP-8 (4.9*3.9) | 4000   | 卷带包装(Tape & Reel) |
| GX175U-T&R | GX175U | MSOP-8 (3*3)    | 4000   | 卷带包装(Tape & Reel) |
| GX175D-T&R | GX175D | DFN-8 (3*2)     | 3000   | 卷带包装(Tape & Reel) |
| GX175N-T&R | GX175N | DFN-8 (2*2)     | 3000   | 卷带包装(Tape & Reel) |

www.galaxy-cas.com 20